

【發明專利 PPH 修正申請書】

【案由】 24716
【申請案號】 100100001
【事務所或申請人案件編號】 TW-0004

【辦理依據】
 【發文日期】 100/11/23
 【智專字】 二(一)05096
 【發文號】 10018704220

【中文發明名稱】 半導體裝置之製造方法

【申請人1】
 【國籍】 TW 中華民國
 【中文姓名】 王,小明

【申請人2】
 【國籍】 JP 日本
 【中文姓名】 呂,小文
 【英文姓名】 LIU,HSIAO WEN

【申請人3】
 【國籍】 US 美國
 【中文名稱】 美商黃海公司
 【英文名稱】 YELLOW OCEAN COMPANY

【代理人1】
 【中文姓名】 歐,小蘭

【代理人2】
 【中文姓名】 陳,小香

【修正事項】
 【說明書修正之頁數及段落編號及行數及修正理由】

1. [中文發明名稱]：「半導體裝置及其製造方法」修正為「半導體裝置之製造方法」。
2. 第[0004]段、第[0052]段：「熱處理」修正為「退火處理」。

【申請專利範圍修正之項號及修正理由】

1. [請求項1]、[請求項5]：「熱處理」修正為「退火處理」。「800度以下」修正為「溫度介於攝氏500~750度間」。
2. [請求項3]、[請求項8]：單句為之。
3. 刪除[請求項2]、[請求項6]、[請求項11~20]。
4. 新增[請求項9~12]。

【其他說明事項】

1. 修正發明名稱使與申請專利之發明標的一致。
2. 統一修正「熱處理」為說明書實施例第[0022]文段所記之用語「退火處理」。
3. 將請求項2、請求項6之溫度併入請求項1、請求項5，以與貴局所援引證區隔。
4. 將請求項3、請求項8誤植之「，」修正為「。」以符規定。
5. 新增請求項9~12係分別依附於請求項1、請求項5，其所進一步界定之技術可見於說明書第[0028]文段之實施例內容所記之金屬矽化物遮罩層材料之選用群組及最佳為氧化矽，並未超出原申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭示之內容。
6. 綜上所陳，經由上述之修正使本案所請各項發明符合專利法之規定，並且相較於引證1,2，修正後之請求發明之製法步驟有較高的良率，不僅能避免習知接觸不良的缺失，且更能達到降低金屬矽化物電阻值之效果，實非發明所屬領域之通常知識者依引證1,2所能輕易完成者，應具有進步性。

【本次修正申請專利範圍-應繳規費有變動者】 是

【原請求項項數】	20
【新增請求項項數】	4
【刪除請求項項數】	12
【修正後之請求項總項數】	12
【本次應加收規費】	3200

【繳費資訊】

【繳費金額】	3200
【收據抬頭】	王小明、呂小文、美商黃海公司

【附送書件】

【基本資料表】	Contact.pdf
【修正後之發明摘要】	AmendmentAbstract.pdf
【修正後之發明說明書】	AmendmentDescription.pdf
【修正後之發明申請專利範圍】	AmendmentClaims.pdf
【修正後之發明圖式】	AmendmentDrawings.pdf
【修正部分劃線之發明摘要】	WithLineAbstractPage.pdf
【修正部分劃線之發明說明書】	WithLinnetDescriptionPage.pdf
【修正部分劃線之發明申請專利範圍】	WithLinnetClaimsPage.pdf

【申請專利範圍對應表】 ClaimsMapping.pdf

【本申請書所檢送之 PDF 檔或影像檔與原本或正本相同】

【申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項-並已確認本申請案之附件-除基本資料表-委任書外-不包含應予保密之個人資料-其載有個人資料者-同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽或抄錄或攝影或影印.】